

**特点:**

- 输出频率: 1260 MHz~1560MHz
- 输出功率: 典型值+1dBm
- 工作温度: -55~+85°C
- SMT 封装
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

**性能参数: (TA=25°C)**

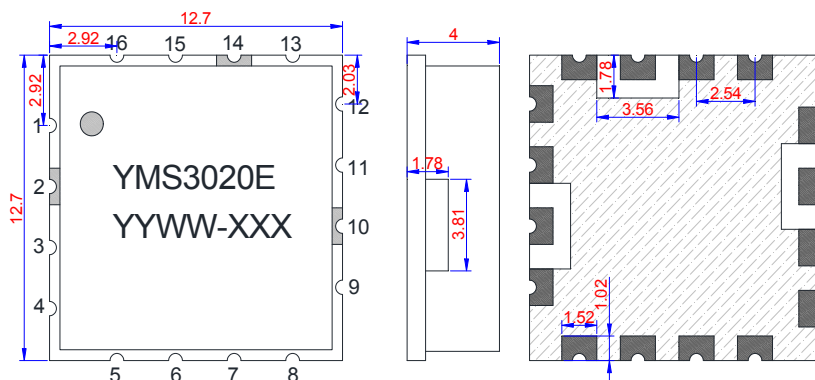
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
输出频率	$F_{out}$	输出端口阻抗: 50Ω 工作电压: 5V	1260		1560	MHz	$V_t=0V\sim 10V$
输出功率	$P_{out}$		-2	+1		dBm	
相位噪声	PN		-100	-95		dBc/Hz	@10KHz, $V_t=6V$
			-123	-120		dBc/Hz	@100KHz, $V_t=6V$
杂波抑制	SR			-75	dBc		
谐波抑制			-15	-10		dBc	
电调灵敏度	Kv		40	50		MHz/V	设计保证
调谐端电容			40			pF	设计保证
电源电压	Vcc		+4.75	+5	+5.25	V	
电源电流	Icc		20	35		mA	
重量			1	2		g	

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	+6	V	贮存温度	-55~+100	°C
$V_T$	12	V			

**封装外形图:**

单位: mm



注: 外形公差±0.2mm, 其他尺寸公差按 GB/T1804—2000 等级 f 执行;

**字符标志:**

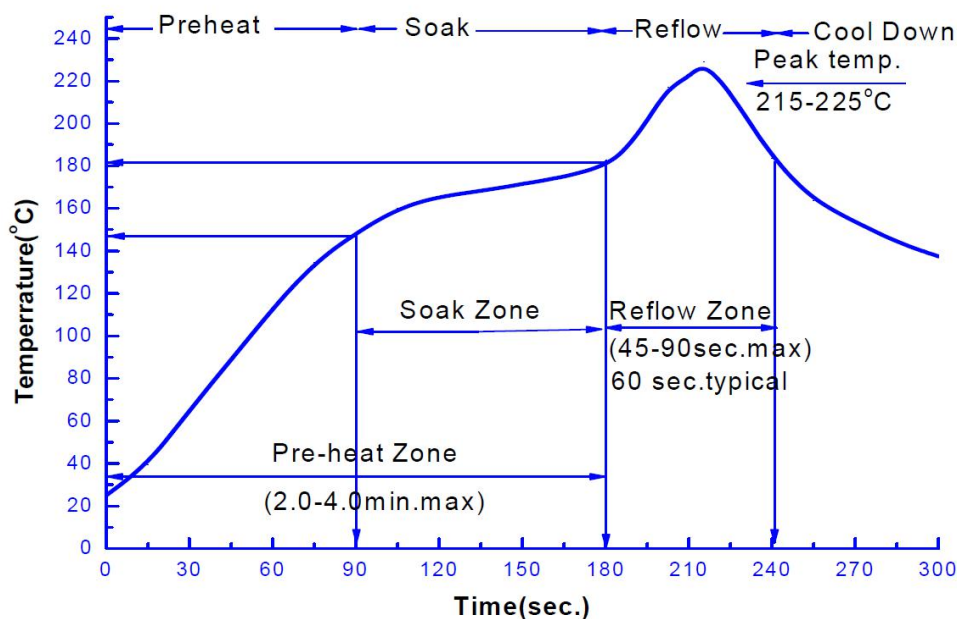
YMS3020E	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号
•	1脚

**引脚定义:**

引脚	符号	定义
2	$V_T$	调谐端
10	RF	输出
14	$V_{CC}$	电源电压
其余	GND	地

**产品使用注意事项:**

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃ 回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。